결정질 실리콘 태양전지의 Al2O3/SiNx 패시베이션 특성 분석

현지연¹⁾ · 송인설²⁾ · 김재은¹⁾ · 배수현¹⁾ · 강윤묵²⁾* · 이해석²⁾* · 김동환¹⁾* ¹⁾신소재공학과, 고려대학교, 서울, 02841 ²⁾그린스쿨대학원, 고려대학교, 서울, 02841

The Properties of Passivation Films on Al₂O₃/SiN_x Stack Layer in Crystalline Silicon Solar Cells

Ji Yeon Hyun¹⁾ • In Seol Song²⁾ • Jae Eun Kim¹⁾ • Soohyun Bae¹⁾ • Yoonmook Kang²⁾* • Hae-Seok Lee²⁾* • Donghwan Kim¹⁾*

¹⁾Department of Materials Science and Engineering, Korea University, Anam-dong, Seongbuk-gu, Seoul 02841, Korea ²⁾KU KIST Green School, Graduated school of Energy and Environment, Korea University, Seoul 02841, Korea

ABSTRACT: Aluminum oxide (Al₂O₃) film deposited by atomic layer deposition (ALD) is known to supply excellent surface passivation properties on crystalline Si surface. The quality of passivation layer is important for high-efficiency silicon solar cell. double-layer structures have many advantages over single-layer materials. Al₂O₃/SiN_X passivation stacks have been widely adopted for high-efficiency silicon solar cells. The first layer, Al₂O₃, passivates the surface, while SiN_X acts as a hydrogen source that saturates silicon dangling bonds during annealing treatment. We explored the properties on passivation film of Al₂O₃/SiN_X stack layer with changing the conditions. For the post annealing temperature, it was found that 500 °C is the most suitable temperature to improvement surface passivation.

Key words: Al₂O₃, Atomic Layer Deposition, Passivation, Crystalline silicon, Solar cells

Nomenclature

Voc : open-circuit voltage, V

subscript

ALD : atomic layer deposition PECVD : plasma enhanced chemical vapor deposition ARC : anti-reflectance coating QSSPC : quasi steady state photoconductance TMA : trimethylaluminum DHF : dilute hydrofluoric acid

1. 서 론

최근 신재생 에너지에 대한 관심이 높아짐에 따라 태양광 에 너지는 폭발적인 에너지 수요에 대응 할 수 있는 에너지 공급원

*Corresponding author: ddang@korea.ac.kr, lhseok@korea.ac.kr, solar@korea.ac.kr

Received June 6, 2017; Revised June 8, 2017; Accepted June 10, 2017

중 하나로 주목 받고 있다. 다양한 종류의 태양전지 중 실리콘을 기반으로 하는 태양전지는 전체 태양광 시장의 약 90% 이상을 차지하고 있다. 최근 모듈 가격의 하락으로 인한 실리콘 태양전 지의 가격 경쟁력 확보를 위해 생산 단가를 낮춤과 동시에 고효 율 구조에 대한 연구가 진행되고 있다^{1-7,15}.

실리콘 태양전지 변환 효율 향상을 위해 웨이퍼 두께 감소, 에 미터 도핑 농도 증가에 따른 표면 패시베이션 특성이 더욱 중요 해지고 있다. 표면 패시베이션 층은 크게 두가지 역할을 수행한 다. 먼저 표면에 존재하는 결함(dangling bond)을 제거하여 표 면 재결함 손실을 줄여준다. 다음으로 패시베이션 층에 형성되 는 고정 전하(fixed charge)의 계면 전기장 형성에 의한 재결함 손실 효과가 있다^{2,10}. 주요 패시베이션층으로 fixed positive charge를 가지고 있는 실리콘 산화막(SiO₂)과 실리콘 질화막 (SiN_X)이 있으며 negative fixed charge를 가진 알루미늄 옥사이 드(Al₂O₃)가 있다¹⁰. 이 중 알루미늄 옥사이드는 높은 밀도의 fixed negative charge를 가져 lowly doped된 p형 또는 n형 실리 콘과 highly doped된 p형 에미터의 field effect 효과를 갖는 패시 베이션 막으로 주요하게 쓰이고 있다¹⁰. 특히 ALD (Atomic layer deposition)를 이용하여 알루미늄 옥사이드(Al₂O₃)를 증 착 할 경우 용이한 막 두께 조절과 균일한 증착으로 우수한 화학

© 2017 by Korea Photovoltaic Society

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. 적 패시베이션 효과를 얻을 수 있다는 장점이 있다.

한편 ALD로 증착된 Al₂O₃ 박막은 열처리를 통해 막 내의 D_{it} 감소와 Qr증가를 가져와 표면 패시베이션의 특성을 향상시킬 수 있다고 알려져 있다. 또한 열처리 과정 중 수소를 주입함으로 써 패시베이션 특성이 더욱 향상된다는 보고도 존재한다⁸). Capping layer로 주로 사용되고 있는 SiN_x는 수소를 많이 함유 하고 있어 실리콘 표면에 존재하는 dangling bond를 패시베이 션 할 수 있도록 수소를 공급하는 소스로 사용되며 동시에 태양 전지 전면의 반사방지막으로 사용된다.

본 연구는 결정질 실리콘 태양전지의 표면 패시베이션 특성 을 향상시키기 위한 연구를 진행하였다. ALD로 Al₂O₃를 증착 하고 박막의 특성을 확인하기 위한 실험을 진행하였다. Al₂O₃의 증착 두께와 온도 및 precursor의 펄스타임에 따른 샘플들의 implied V_ac를 측정 및 비교하였고, 패시베이션 특성이 최대가 되는 증착 조건을 확인하였다. 다음으로 Al₂O₃ 박막 위 capping layer로 SiN_x를 증착 후 열처리를 진행하였고 열처리 순서와 온 도조건을 다르게 하였으며 패시베이션의 특성 확인을 위해 QSSPC 측정을 진행하고 결과를 비교하였다.

2. 실 험

패시베이션 박막의 특성을 확인하기 위해 본 연구에서는



Fig. 1. (a) Al₂O₃ structure (b) Al₂O₃/SiN_x stack layer structure



Fig. 2. Fabrication procedure for crystalline silicon solar cells

Czochralski (Cz) 법을 통해 성장된 5-20 Ω • cm 비저항의 Boron (B)이도핑된두께 180 /m, 크기6 inch의 p-type (100) 실리콘 웨 이퍼를 사용하였다. 절삭면 식각(saw damage etching) 후 요철 구조(texturing)를 형성하여 광흡수를 늘렸다. 그 후 native oxide 에 의한 변수를 줄이기 위해 DI와 HF를 9.4: 1.3의 비율로 희석 한 용액을 제조하여 Dilute Hydrofluoric Acid Cleaning (DHF) 을 진행하였다. 패시베이션의 공정 조건을 확인하기 위해 ALD 를 이용하여 Al₂O₃를 증착 하였고 제작한 샘플의 구조는 Fig. 1 (a)에 나타내었다. 알루미늄 옥사이드 (Al₂O₃)막 형성을 위해 precursor로는 알루미늄 소스로서 TMA (trimethylaluminum Al(CH₃)₃)와 산소 소스로서 H₂O가 각각 사용되었다. Cycle 수 를 다르게 하여 3~10 nm 두께 별로 증착을 하였고 온도에 대한 영향을 알아보기 위해서 180~260℃ 분위기에서 증착을 하였 다. 펄스 타임에 따른 막 두께에 대한 영향을 확인하기 위해서 Elipsometry를 이용하였고 펄스 시간을 0.1~1.1 sec로 다르게 하여 QSSPC를 통하여 특성을 비교하였다. 다음으로 capping layer로 사용되는 SiNx 박막은 PECVD를 이용하여 증착하였으 며 Al₂O₃와 SiN_x를 적층 구조로 하였을 때의 샘플 구조는 (b)에 나타내었다. 열처리에 대한 영향을 알아보기 위해서는 Al₂O₃/ SiNx 증착시SiNx 를 증착하기 전후RTP (rapid thermal processing) 를 이용하여 각각 500~600℃로 온도를 다르게 하여 특성을 비 교하였다. 해당 공정 순서는 Fig. 2에 나타내었다.

3. 결과 및 고찰

3.1 ALD 증착 조건에 따른 Al₂O₃ 박막 패시베이션 특성 평가

Fig. 3은 ALD의 공정 cycle 수를 조정하여 Al_2O_3 의 두께를 3 nm부터 10 nm까지 다르게 하였을 때 implied V_{∞} 측정 결과를 나타낸다. 두께가 증가함에 따라 implied V_{∞} 값이 증가하는 결 과를 확인하였다. 이는 Al_2O_3 박막의 field effect 패시베이션 효



Fig. 3. Effects of Al₂O₃ thickness on V_{oc}

과와 관련 있을 것으로 예상한다. Al₂O₃ 내부의 negative fixed charge는 Si과 Al₂O₃ 표면에 형성된다고 많이 보고 되고있다. Si 표면에 Al₂O₂가 충분히 두껍게 증착 되지 않을 경우 표면에 존재 하는 charge density가 낮아 field effect passivation 효과가 크지 않다고 생각된다. 따라서 적은 cycle 수로 얇게 증착이 될 경우 낮은 V_{oc}값을 갖는 것은 실리콘 표면에 negative charge density 가 낮게 되어 minority carrier가 표면에서 재결합되는 속도가 상 대적으로 높아서 낮은 패시베이션 특성이 나온 것으로 생각된 다. 이후 ALD 조건 변화 실험은 모두 10 nm에서 진행하였다.

Fig. 4는 증착 온도를 20℃ 간격으로 다르게 하였을 때 온도에 따른 implied V_∞의 경향을 보여준다. 온도가 증가할수록 V_∞도 증가하지만 220℃를 기점으로 하락하는 결과를 관찰하였다. 이 미보고된 내용으로는 Al₂O₃ 증착 후 일정 온도 이상에서는 재결 합 속도에 대한 차이가 거의 없었으나^{2,9)} 열처리공정 이후 기판 온도에 따라 패시베이션 특성 차이가 확연히 드러나는 것으로 나왔다. 우리 연구는 이와는 다른 결과로 열처리 공정 전에 220℃ 에서 implied V_∞ 값이 가장 높게 나온 것을 확인 하였다. 다음으

700

680

660

640

620

600 580

560 540

mplied Voc (mV)

로 ALD의 공정 cycle 수를 동일하게 하였을 때 TMA와 H₂O의 펄스 타임에 따른 막 특성을 확인하였다. Elipsometry를 이용하 여 각 증착 조건 별 두께를 측정한 결과를 Fig. 5에 나타내었다. 평균 두께는 차이를 보이지 않았으나 H₂O보다 TMA의 펄스타 임이 웨이퍼 내의 두께 균일도에 영향을 보이는 것으로 확인하 였다.

Fig. 6은 공정 온도 220℃, Al₂O₃ 10 nm로 증착시 TMA펄스 타임을 0.5 초로 하였을 때 H₂O 펄스 타임에 따른 implied V_∞ 결과를 보여준다. 0.1 초 이후부터 V_∞의 급격한 증가를 보이나 일정 펄스 타임의 증가가 V_∞에는 영향이 없음을 확인할 수 있 다. 기존에 발표된 내용에도 ALD는 원자층으로 증착이 되기 때 문에 펄스 타임이 증가하여도 1 cycle당 성장하는 막의 성장속 도가 동일할 뿐만 아니라 특성 또한 차이가 없는 것으로 확인되 었다. 다만 0.1초에서 감소를 보이는 원인에 대해서는 펄스 타 임이 충분하지 않을 경우 Al₂O₃ 형성 시 산소 소스의 부족으로 균질한 막이 형성 되지 않았기 때문에 특성이 나오지 않은 것으 로 보인다.



Fig. 4. Substrate temperature of atomic layer deposition (ALD)

Fig. 6. Effects of pulse time on Voc



Fig. 5. Effects of pulse time on thickness. Films were deposited at 220°C (Elipsometry)

1.2



Fig. 7. (a) pre annealing process on different annealing temperature (b) post annealing process on different annealing temperature (QSSPC)

3.2 Al₂O₃ 박막의 열처리 및 capping layer (SiN_x) 유무에 따른 패시베이션 특성 변화

Al₂O₃증착 후 열처리공정을 하게 될 경우 Q_f가 증가하게 되며 D_i가 감소하게 되어 패시베이션의 특성이 좋아진다고 알려져 있다. Fig. 7은 capping layer 유무에 따른 패시베이션 특성 결과 를 보여준다. Al₂O₃증착 후 capping layer 없이 열처리를 하게 될 경우 SiNx 증착 후에 값이 하락하지만 capping layer 증착 후 열 처리를 할 경우 값이 더 높은 값을 얻는 것을 확인할 수 있다. 이 를 통해 capping layer 인 SiNx를 증착 후 열처리를 하게 될 경우 열처리 과정 중 defect sites를 패시베이션 해줄 수 있는 충분한 수소 공급이 가능하다는 것으로 해석할 수 있다. 반면에(b)의 결 과를 보면 온도가 증가함에 따라 implied V_{ac}값이 하락하는 경향 을 보인다. 열처리 온도의 증가로 수소가 표면 밖으로 outdiffusion 된다는 가능성도 있지만 수소의 검출이 매우 힘들다는 것과 그 양이 적다는 보고가 있다¹¹⁾. 또한 SiNx는 Si-H와N-H 결 합이 존재하며 수소의 탈착과 움직임은 온도에 의존하게 된다¹¹⁾. R (NH₃/SiH₄) 값에 따라서도 열처리 온도에 따른 수소화 경향이 달라진다는 보고가 있다¹¹⁾.

따라서 Al₂O₃와 SiN_x 각각에 대해서 열처리 온도를 다르게 하여 FTIR을 이용하여 결합에너지를 측정해 볼 계획이며 수소 의 함량을 다르게 하여 패시베이션 특성에 대해 파악할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

4. 결 론

ALD를 이용한 결정질 실리콘 태양전지의패시베이션 막 특 성을 확인하기 위해서 두께, 온도, 펄스타임을 조절하여 개방전 압을 측정하였다. 두께증가에 따라 특성이 증가하였으며 특정 온도를 기준으로 개방전압이 변하였다. 펄스타임이 미치는 영 향은 거의 없었으며 일정하게 유지되는 것을 확인하였다. SiNx 를 증착하여 적층구조를 형성하였을 때 열처리 온도가 500℃ 일 때 높은 값을 보였다. Capping layer 증착 전보다 증착 후에 열처 리를 진행하였을 경우 수소의 공급으로 패시베이션의 특성이 더 우수한 것으로 보인다. Al₂O₃와 SiN_x 각각을 열처리 하여 결 합 에너지를 비교해 본다면 패시베이션 특성 파악에 대한 이해 를 기대할 수 있다.

후 기

본 연구는 2017년도 산업통상자원부의 재원으로 한국에너 지기술평가원(KETEP)의 지원을 받아 수행한 연구 과제입니다 (No.20153010012100).

References

- Chen, Y., "Independent Al2O3/SiNx:H and SiO2/SiN x:H Passivation of p+ and n+ Silicon Surfaces for High-Performance Interdigitated Back Contact Solar Cells." IEEE Journal of Photovoltaics, Vol. 7, No. 1, pp. 51-57, 2017.
- 2. Dingemans, G., "Status and prospects of Al2O3-based surface passivation schemes for silicon solar cells." J. of VSTA, Vol. 30, No. 4, pp. 040802, 2012.
- Von Gastow, G., "Analysis of the atomic layer deposited Al2O3 field-effect passivation in black silicon." Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol. 142, pp. 29-33, 2015.
- Feldmann, F., "Passivated rear contacts for high-efficiency n-type Si solar cells providing high interface passivation quality and excellent transport characteristics." Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol. 120, pp. 270-274, 2014.

- Cornagliotti, E., "Large-area n-type PERT solar cells featuring rear p+ emitter passivated by ALD Al2O3" IEEE Journal of Photovoltaics, Vol. 5, No. 5, pp. 1366-1372, 2015.
- Davidsen, R. S., "Black silicon laser-doped selective emitter solar cell with 18.1% efficiency." Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol. 144, pp. 740-747, 2016.
- Battaglia, C., "High-efficiency crystalline silicon solar cells: status and perspectives." Energy & Environmental Science, Vol. 9, No. 5, pp. 1552-1576, 2016.
- Dingemans, G., "Stability of Al2O3 and Al2O3/a-SiNx:H stacks for surface passivation of crystaliine silicon." J.of AP Vol. 106, No. 11, pp 114907, 2009.
- Dingemans, G., "Influence of the deposition temperature on the c-Si surface passivation by Al2O3 films synthesized by ALD and PECVD." Electrochemical and Sold-state letters Vol. 13, No. 3, pp. H76-H79, 2010.
- Richter, A., "Aluminum oxide for the surface passivation of high efficiency silicon solar cells: Technology and advanced characterization", Fraunhofer Verl, 2015.
- Lelièvre, J. F., "Study of the composition of hydrogenated silicon nitride SiNx:H for efficient surface and bulk passivation of silicon." Solar Energy Materials and Solar Cells, Vol. 93, No. 8, pp. 1281-1289, 2009.